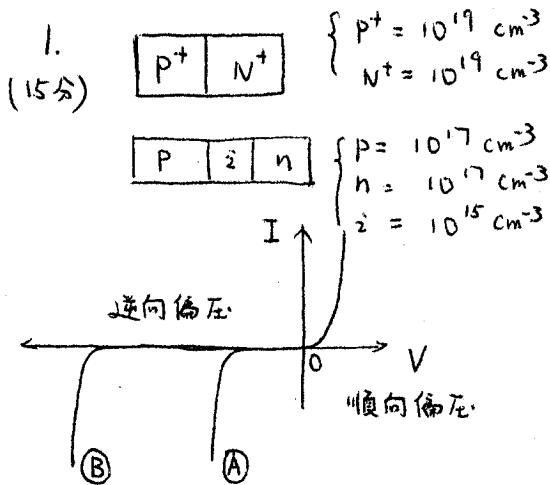
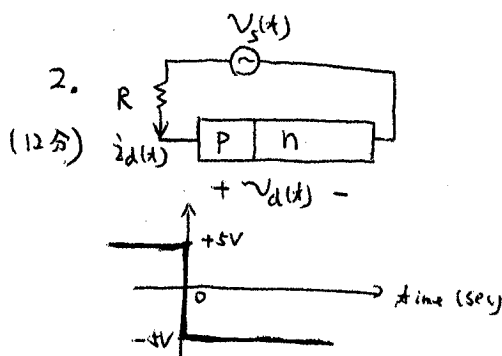


系所別： 電機工程學系 乙組 科目： 半導體元件

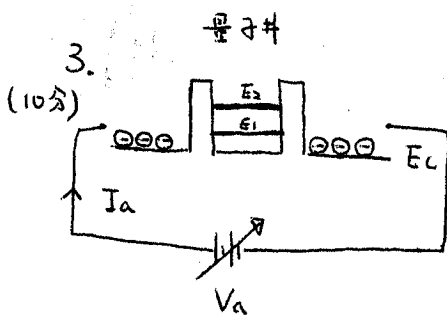


左圖有兩個 p-n 接面 = 極體，分別是 $p^+ - n^+$ 及 $p - i - n$ 的結構，今分別量測此 = 極體 I-V 特性，在逆向操作偏壓時，其崩潰的曲線是 (A) 及 (B)。請問 (A) 及 (B) 分別代表為那種 p-n 接面 = 極體？其二極體之前潰 (break down) 機制有何不同，請分別加以說明？如果我需要一個可變電容器 (varactor, 亦即利用偏壓來改變接面電容值)，我會使用那種 p-n 接面 = 極體？並說明原因。

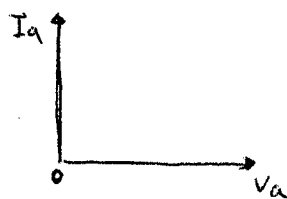


左圖之 p-n 接面，其外加電源 $V_s(t)$ 在 $t=0$ sec 時，由 $+5V$ 變為 $-5V$ ，請畫出跨在 = 極體的電壓 $V_d(t)$ 及電流 $i_d(t)$ ，隨著時間會有什麼變化，並解釋原因。

參考用



左圖為一特別半導結構之 E_c 圖，其中間形成一量子井，在井內形成兩個能階 (E_1 及 E_2)。今外加一可變電壓源 V_a ，由 $0V$ 往正偏壓增加，請畫出 I_a 與 V_a 關係的作圖 (如左圖)，並說明原因。



4. (13分) 半導體很多的特性是由能隙 (bandgap) 所決定，其代表電子的能量是不能存在於能隙裏面，此能隙亦即所謂的能隙不連續的特性是由什麼原因所形成？而能隙又分為直接能隙 (direct bandgap, 如 GaAs) 及間接能隙 (indirect bandgap, 如 Si)，請問何種能隙在電子電洞的產生及結合 (generation and recombination) 有著較高的效率並加以解釋。

注意：背面有試題

系所別: 電機工程學系 乙組 科目: 半導體元件

5. (5%) (a) Sketch the energy band diagram for the electrons in an NPN transistor for saturation.
(5%) (b) Why the base width an important dimension in the quality of a transistor?
(5%) (c) Write the Ebers-Moll equations for an NPN transistor.
6. Assume we have an MOS device that has silicon P substrate with $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and uses aluminum for the gate. The fixed charge $Q_f = 5 \times 10^{10} \text{ qC/cm}^2$. $\epsilon_{\text{Si}} = 11.8 \times 8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$. $\epsilon_{\text{ox}} = 3.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$. $KT/q = 0.026 \text{ V}$. The intrinsic concentration $n_i = 1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, the energy gap $E_g = 1.12 \text{ eV}$, and the affinity $\chi_s = 4.15 \text{ eV}$ for silicon. The oxide thickness $t_{\text{ox}} = 100 \times 10^{-8} \text{ cm}$. The work function $q\Phi_m = 4.1 \text{ eV}$ for aluminum.
(5%) (a) Determine the width of the depletion layer at the onset of strong inversion, $W_m(\text{cm})$
(5%) (b) Determine the flatband voltage $V_{\text{FB}}(\text{V})$
(5%) (c) Determine the threshold voltage $V_T(\text{V})$.
7. (10%) Compare the isolation processes used in the fabrication of the BJT and the MOSFET. Which one has the higher packing density? Sketch the cross-section view for (a) 2 isolated NPN BJT in the same P-substrate, (b) 2 isolated N-channel MOSFETs in the same P-substrate.
8. (10%) Use the device of Problem 6 to determine the required substrate bias that will increase the threshold voltage from V_{T0} to $V_{T0} + 0.5 \text{ V}$, where V_{T0} is the original threshold voltage.

參考用